

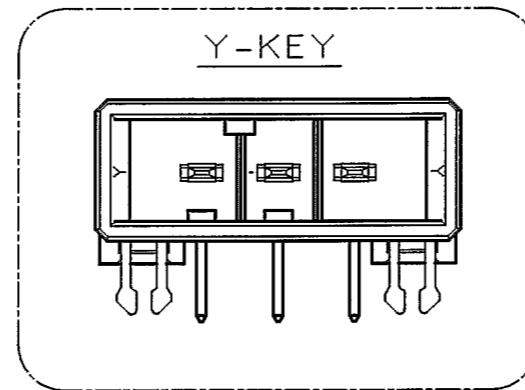
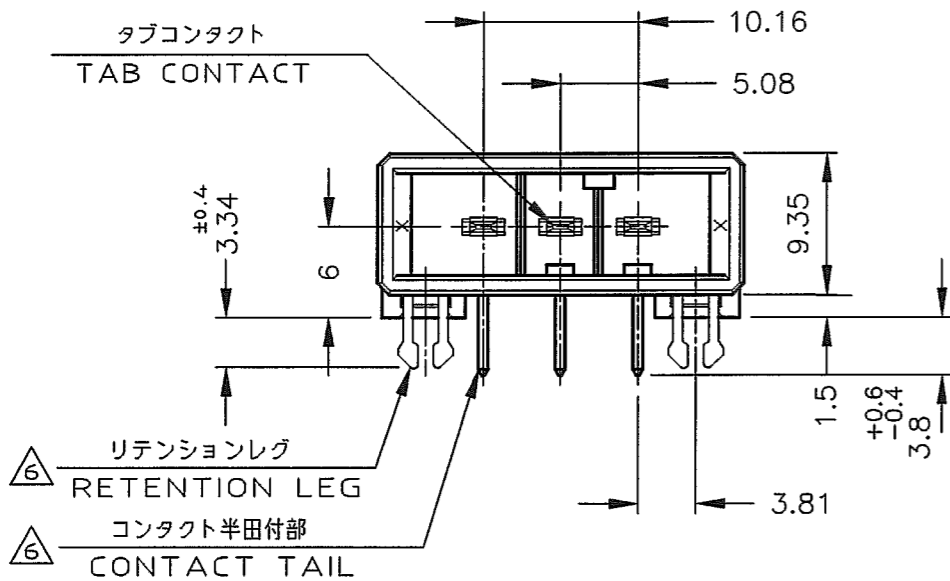
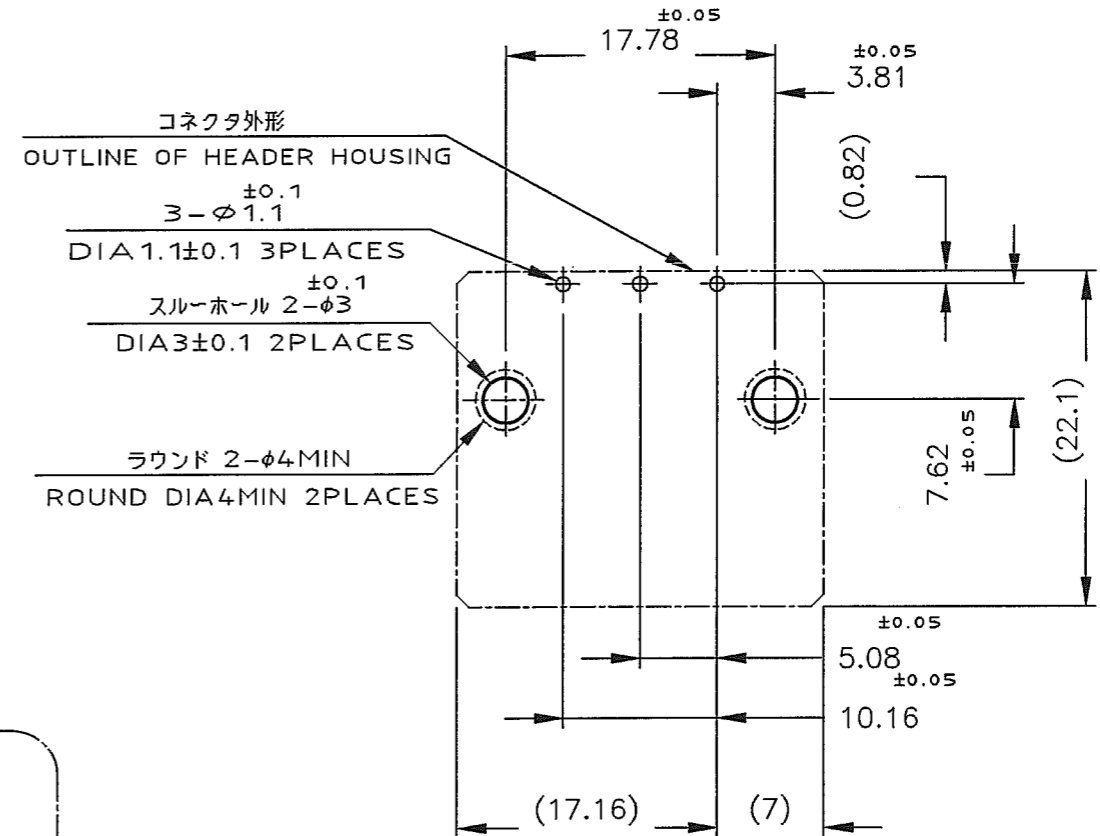
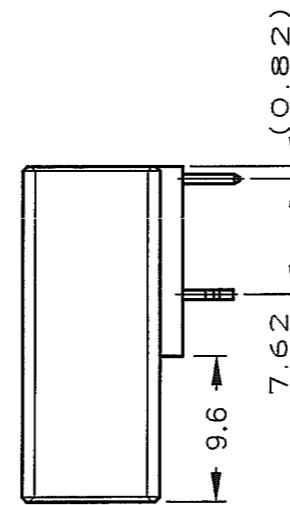
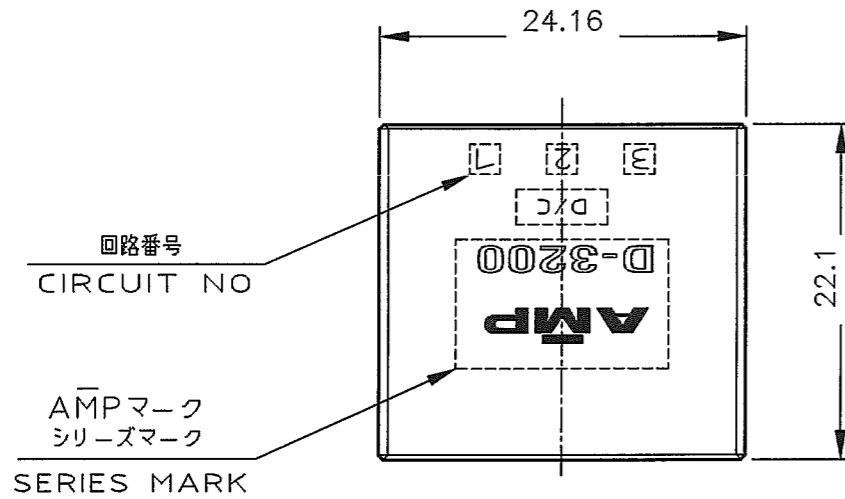
NUMBER 178138

3rd ANGLE PROJECTION

METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



推奨基板取付け穴寸法
PC 基板厚: 1.6 ± 0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	2-178138-5	Y
△6	△3	2-178138-3	Y
△6	△2	2-178138-2	Y
△6	△4	1-178138-5	X
△6	△3	1-178138-3	X
△6	△2	1-178138-2	X
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)	KEY

WIRE RANGE		INSULATION DIA	NAME	
mm ² (AWG -)		mmφ	3 POS SINGLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3200	
MATERIAL SEE NOTE 注記参照		FINISH SEE NOTE 注記参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE LOC NUMBER
DR. 20/MAR/95 K.IKEDA		DE. 20/MAR/95 K.IKEDA	10MF : ±0.3	A3 J C-178138
CHK. 23/MAR/95 S.MANABE		APP. 23/MAR/95 S.MANABE	10MB 30MF : ±0.4	SCALE REV. SHEET
E1 REVISED PER ECO-11-005030		RK HMR 23/MAR/11	30MB 100MF : ±0.5	2-1 E1 1 OF 1
LTR REVISION RECORD		DR CHK DATE	公差 : ±3'	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)

[>>点击查看相关商品](#)